

**Zariadenie pre šablónovú tlač SMD SB-03**

<b>Obj. číslo:</b>	106600004
<b>Dostupnosť:</b>	4 - 8 týždňov

**Popis**

Zariadenie na jednoduchú aplikáciu spájkovacej pasty pomocou šablón. Určené pre malé puzdrá a akékoľvek typy komponentov, napr. BGA, micro BGA, QFN, Flex, ai.

**Obsah balenia**

Zariadenie pre šablónovú tlač SMD SB-03